

株式会社東京精密 2016年度 第2四半期 決算説明会

2016年11月11日
株式会社東京精密
代表取締役社長CEO 吉田 均
証券コード 7729

*

- ◆ 本プレゼンテーション資料で提供する情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- ◆ これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- ◆ 従って、今後の当社の実際の業績が、本プレゼンテーション資料における記述と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。



2016年度 上期業績 概要

単位: 億円(配当除く)	15年度		16年度		
	上期	下期	上期	前下期比 H/H	前年同期比 Y/Y
売上高	380	323	372	+15%	-2%
半導体製造装置	239	179	243	+36%	+2%
計測機器	141	144	129	-10%	-8%
営業利益	76	56	66	+18%	-14%
半導体	48	25	44	+78%	-8%
同率	20%	14%	18%	-	-
計測	28	31	21	-31%	-24%
同率	20%	21%	17%	-	-
経常利益	77	56	63	+14%	-17%
親会社株主に帰属する 当期純利益	55	42	47	+10%	-15%
1株配当	26円	33円	34円	+1円	+8円

* 1株配当 30円→34円へ修正

Copyright 2016 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

3

○ 2016年度上期(4-9月)の業績概要

売上高 372億円 (半導体製造装置 243億円、計測機器 129億円)

営業利益 66億円 (半導体 44億円、計測21億円)

経常利益 63億円、親会社株主に帰属する当期純利益(以下当期純利益) 47億円

○ 全社業績は、概ね、公表済の上期予想どおりの着地となった

○ 中間配当は、30円→34円に修正

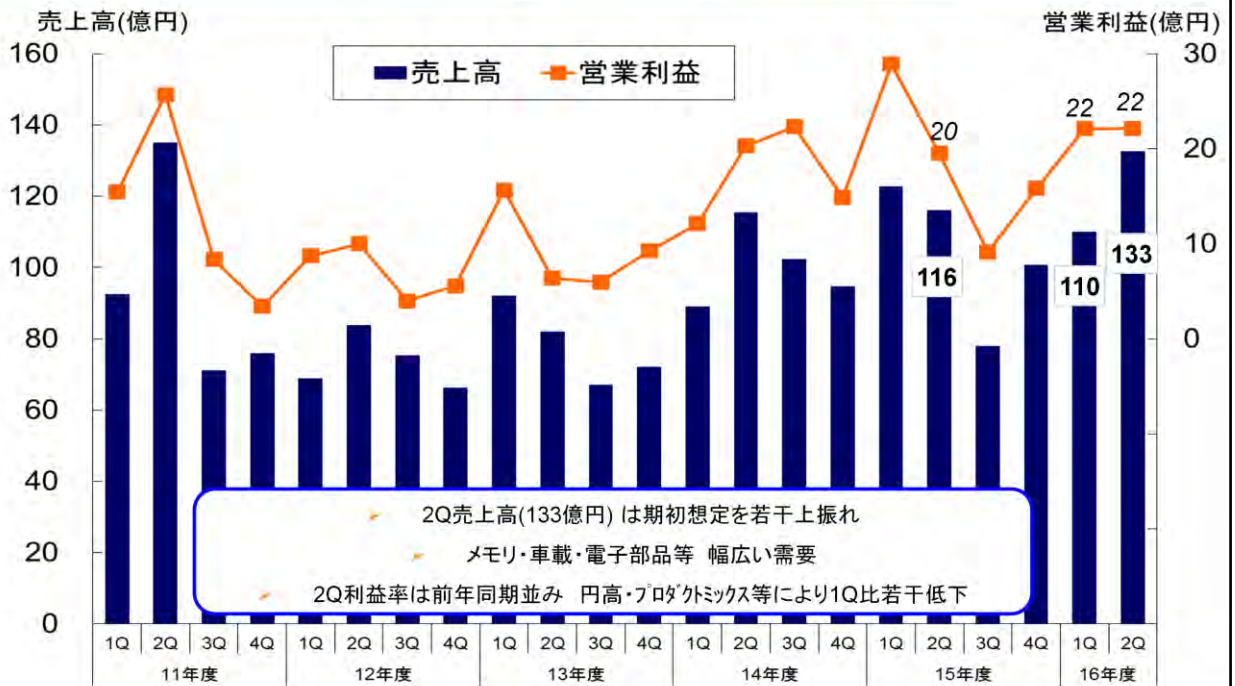
(詳細は、2016年11月11日公表の「業績予想並びに剰余金の配当及び
期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください)

2016年度 第2四半期業績

単位: 億円	2015年度				2016年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前 四 半 期 比 Q/Q	前 年 同 期 比 Y/Y
売上高	184	196	144	179	163	209	+28%	+6%
半導体製造装置	123	116	78	101	110	133	+21%	+14%
計測機器	61	80	66	78	53	76	+43%	-5%
営業利益	39	38	22	34	29	37	+30%	-1%
半導体	29	20	9	16	22	22	-1%	+13%
同率	24%	17%	12%	16%	20%	17%		
計測	10	18	13	18	6	15	+141%	-16%
同率	16%	22%	19%	23%	12%	20%		
経常利益	39	37	23	32	26	38	+45%	+0%
<small>親会社株主に帰属する</small> 当期純利益	28	27	17	25	19	28	+49%	+3%

- 2016年度第2四半期(7-9月、以下2Q)の業績概要
 - 売上高 209億円(半導体 133億円、計測 76億円)
 - 営業利益 37億円(半導体 22億円、計測 15億円)
 - 経常利益 38億円、 当期純利益 28億円

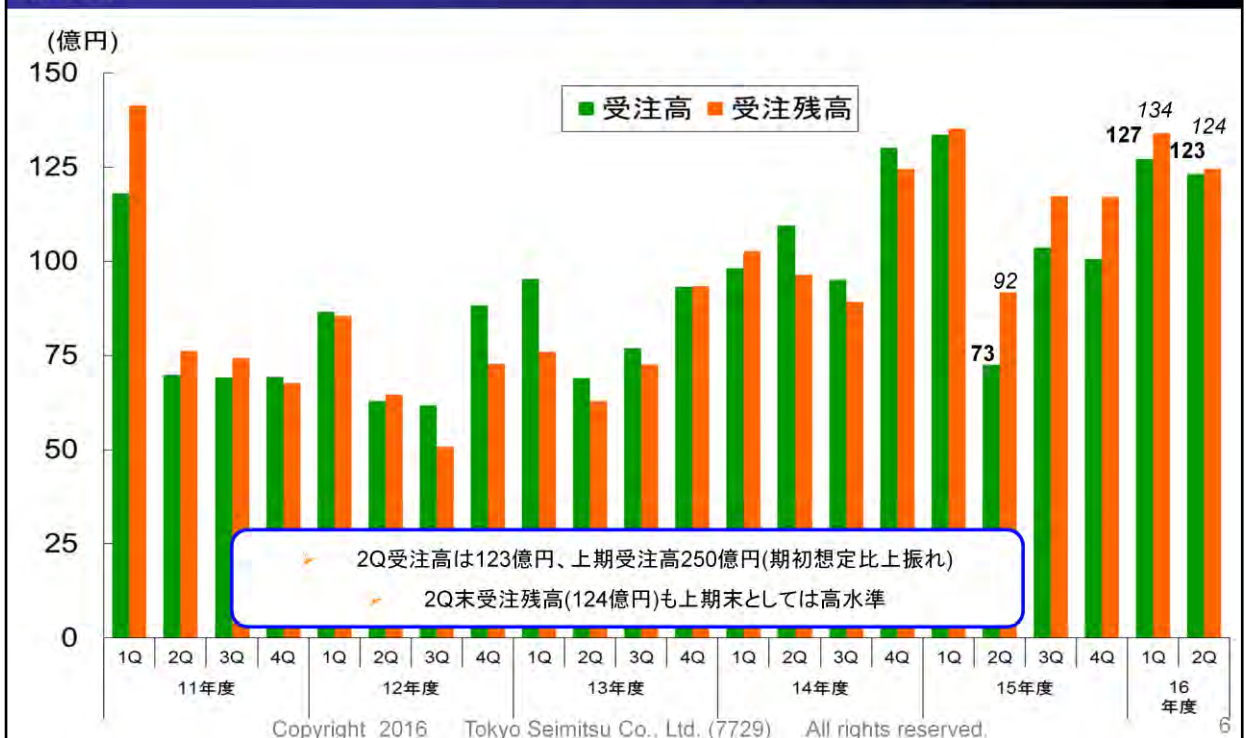
半導体事業 - 売上・営業利益推移



○ 半導体事業の2Q売上は、メモリ・車載・電子部品等、幅広い分野で底堅い動きとなり、期初想定を若干上回った

○ 2Q利益率は前年同期並み、円高・プロダクトミックス等により、1Q比 若干低下した

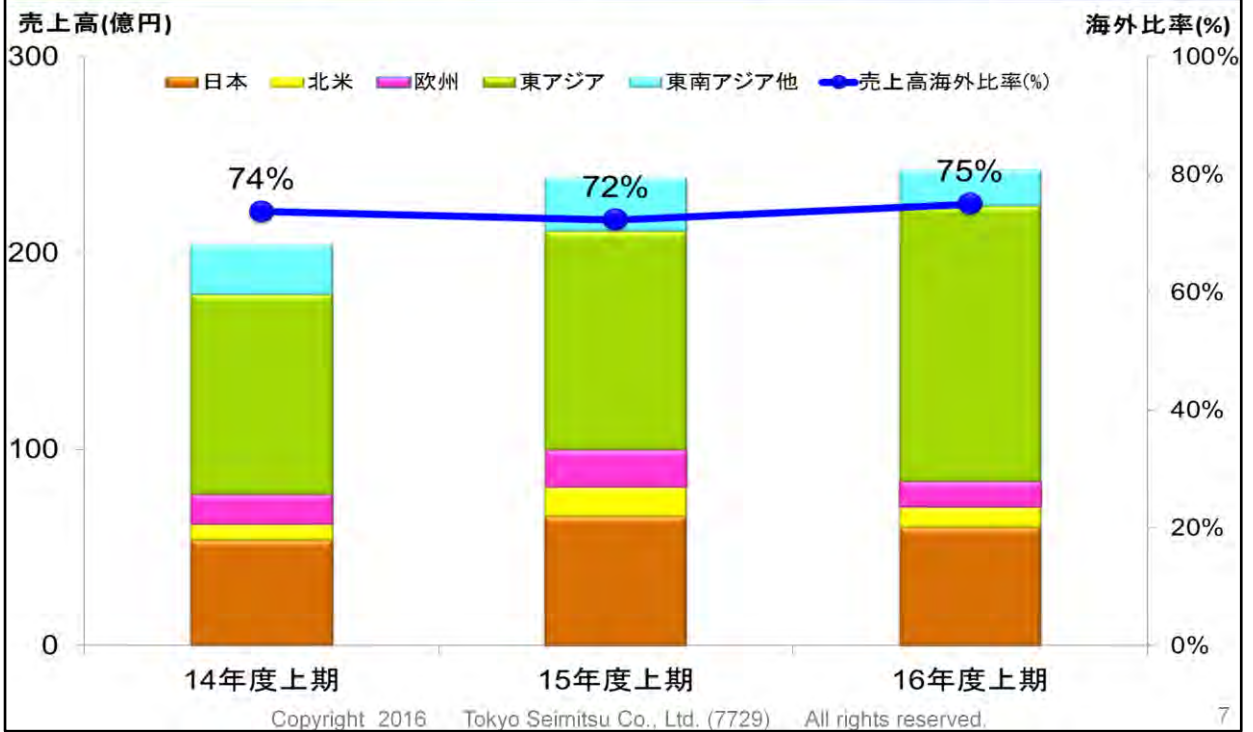
半導体事業 - 受注・受注残高推移



- 半導体事業の2Q受注高は123億円、上期受注高は250億円、2Q末受注残高は124億円
- 2Qの季節性による受注減少が今年度は軽微で、上期受注高は期初想定を上回った
- 上期末受注残高も高水準



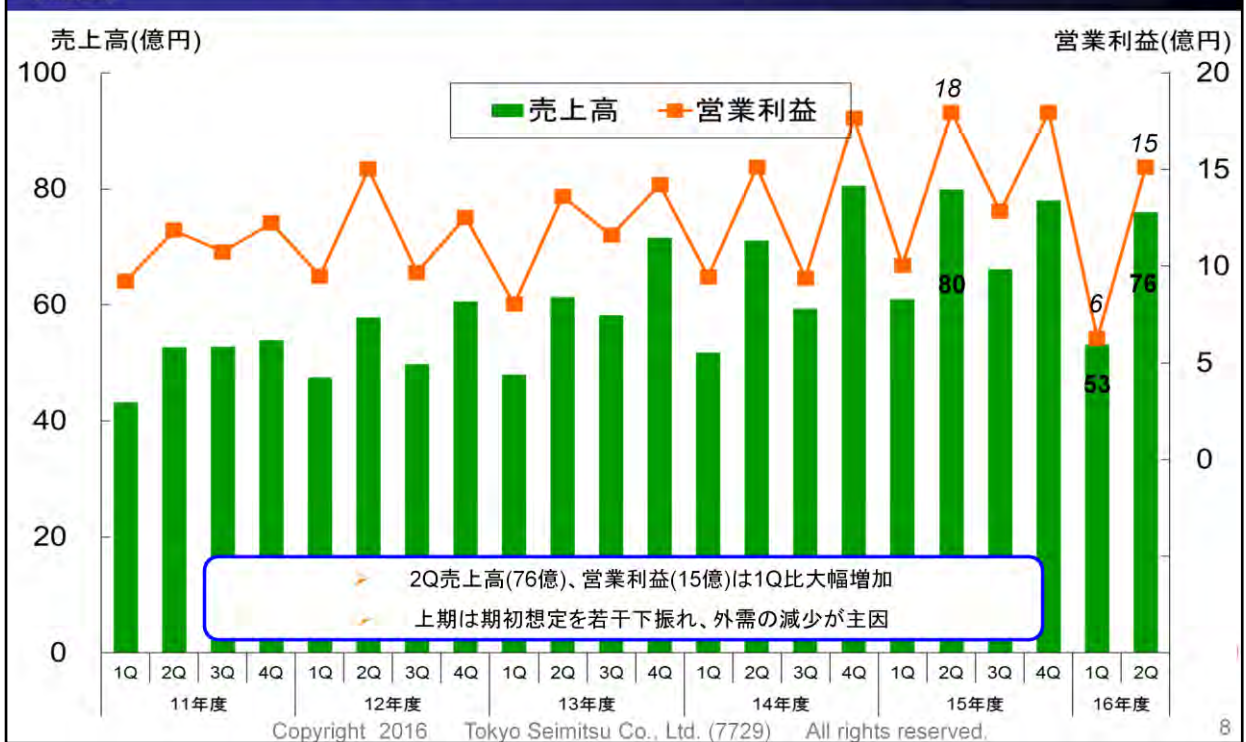
半導体事業 - 地域別売上高推移



○ 半導体事業の16年度上期海外比率は、75%

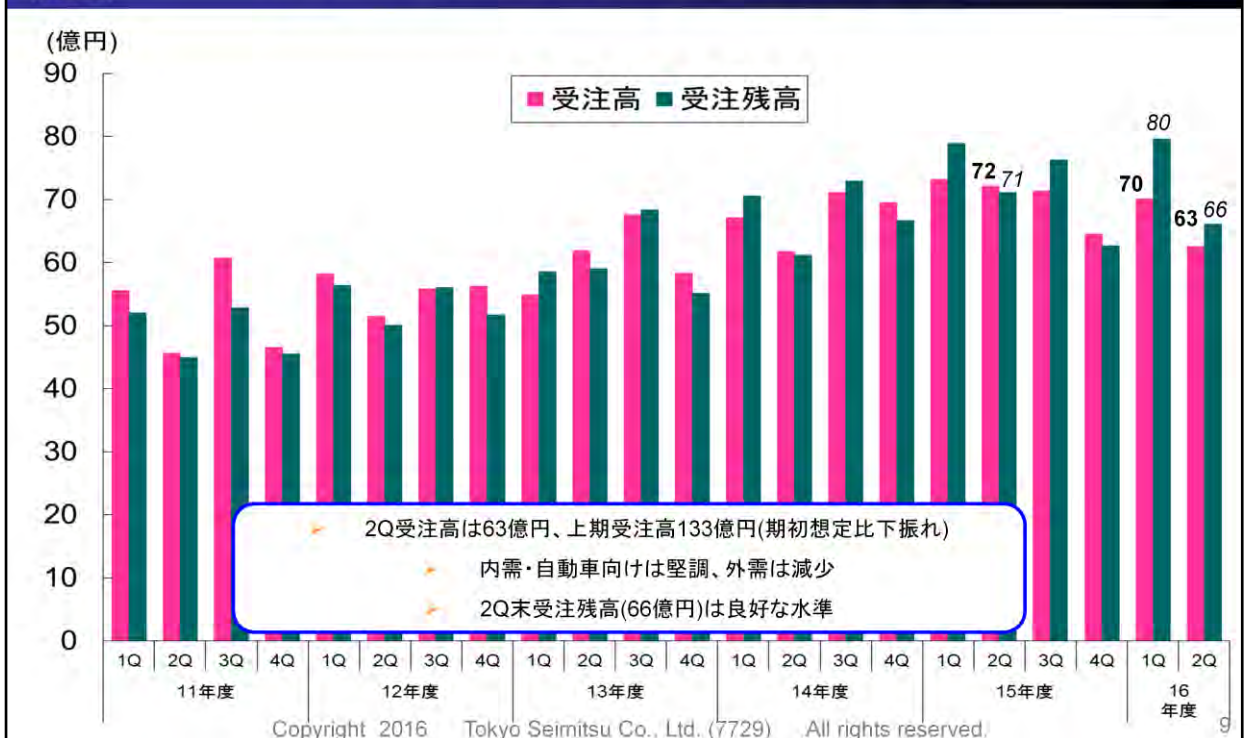
○ 東アジア地域(緑色)の売上が増加
これは、台湾向けが堅調、中国向けが増加したため

計測事業 - 売上・営業利益推移



- 計測事業の2Q売上高(76億)及び営業利益(15億)は、1Q比大幅増
- 上期全体では期初想定・前年同期比 共に下回った
外需が減少した事が主な要因

計測事業 - 受注・受注残高推移



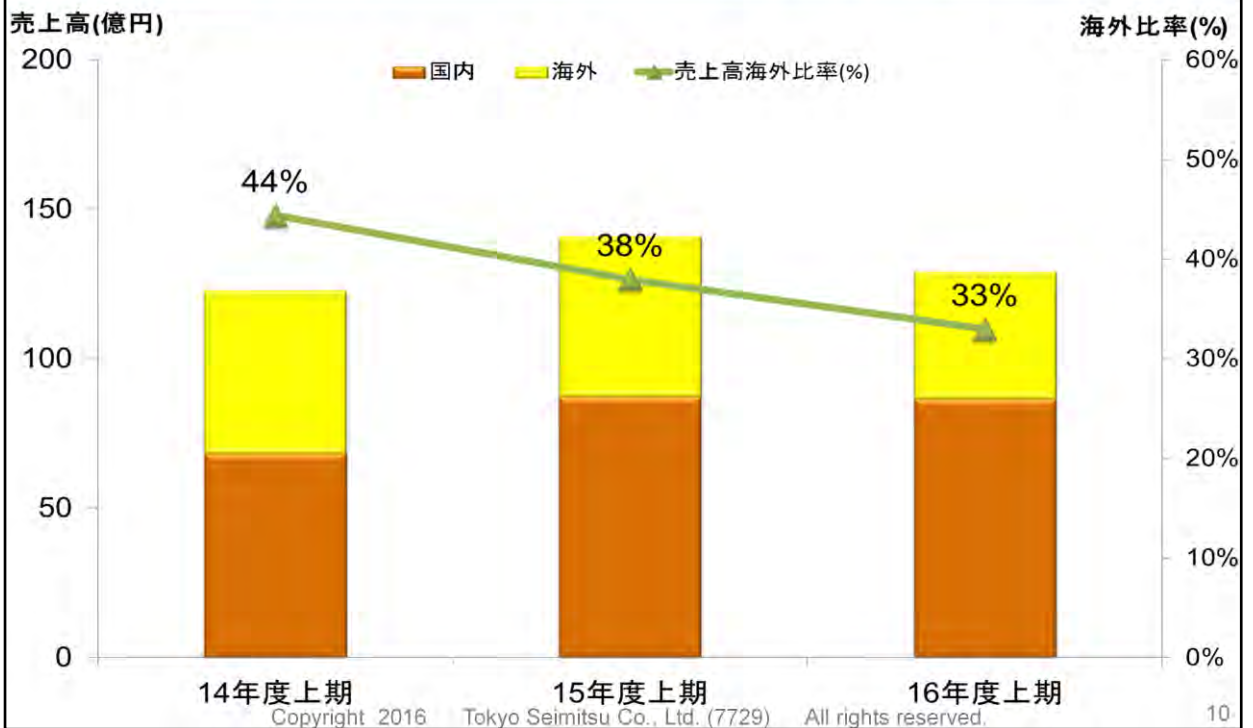
○ 計測事業の第2Q受注高は63億円、上期受注高は133億円
 上期末受注残高は66億

○ 内需・自動車向けは堅調ながら、外需が低迷し上期受注は期初想定を下回った

○ 受注残高は良好な水準



計測事業 - 地域別売上高推移



○ 計測事業の上期海外比率は33%

○ 国内需要は前年並みだが、中国や東南アジア向け引き合いが減少

2016年度 第2四半期 貸借対照表

資産 (億円)	16/3末	16/9末	増減	負債/純資産 (億円)	16/3末	16/9末	増減
現預金	274	303	+29	支手・買掛金、 電子記録債務	118	145	+27
受取手形・ 売掛金・ 電子記録債権	260	253	-7	短期借入金	12	12	±0
在庫	161	164	+3	その他	84	60	-24
その他	32	21	-11	流動負債計	214	217	+3
流動資産計	727	741	+14	固定負債計	11	10	-1
固定資産計	292	307	+15	負債計	225	228	+3
資産合計	1,019	1,048	+29	純資産	794	821	+26
				負債・純資産合計 (内有利子負債)	1,019 (16)	1,048 (14)	+29 (-2)

- 16年9月末総資産 1,048億円(3月末比29億円増)
- 資産 増減内訳： 流動資産 14億円増加、固定資産 15億円増加
 - 流動資産： 現預金 29億円、在庫 3億円の増加、売上債権 7億円減少
 - 固定資産： 八王子第6工場の竣工による建物・構築物の増加が主因
- 負債合計は228億円(3億円増)、純資産は 821億円(26億円増)
- 自己資本比率は 77.5%、9月末 有利子負債残高は14億円

2016年度 上期キャッシュフロー

単位:億円		14年度上期	15年度上期	16年度上期
現金等 期首残高		204	268	273
営業活動	税引前・償却前利益	71	88	75
	(売上債権+在庫) - 仕入債務	17	- 5	27
	納税	- 13	- 24	- 19
	その他	- 3	- 4	3
	小計	71	56	86
投資活動		- 11	- 30	- 37
フリーキャッシュフロー		60	27	49
財務活動	社債・借入	- 2	- 2	- 2
	株式・配当金、他	- 5	- 13	- 14
	小計	- 7	- 15	- 16
増減額(含 換算差額・連結範囲変更)		53	13	30
現金等 期末残高		257	281	303

- 営業活動キャッシュフロー(以下CF)は、86億円のプラス(利益計上等が主因)
- 投資活動CFは、37億円のマイナス(工場建設関連の支出等が主因)
- この結果、フリーCFは49億円
- 財務活動CFは、16億円のマイナス
- この結果、期末の現金等の残高は303億円



従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の合算

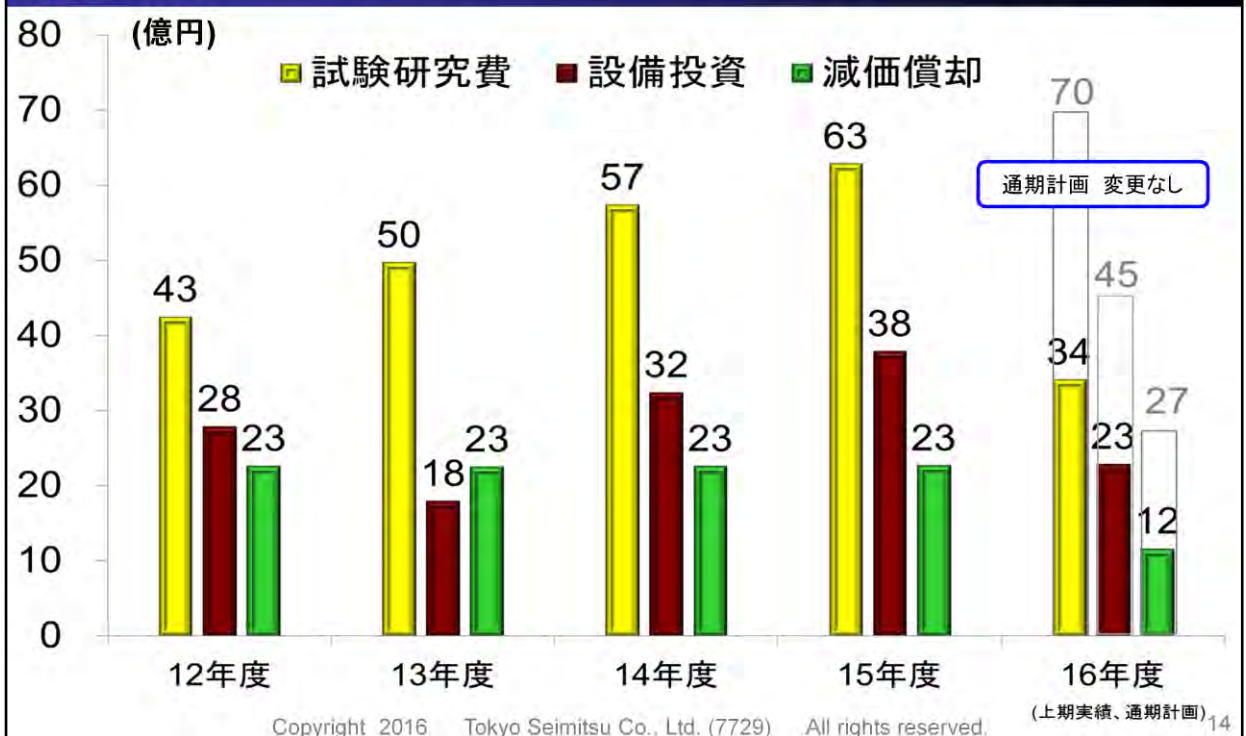
○ 9月末の連結従業員数(臨時含む)は2,479名 3月末比 215名の増加

○ 増加の主な要因は、

- 単体及び国内子会社: 開発及び製造人員の増加
- 海外子会社: 営業・サービス人員の増加

および、タイ子会社連結化による 製造人員の増加

試験研究費、設備投資、減価償却 推移



- 上期の試験研究費実績は34億円(製品競争力強化)
- 同 設備投資実績は23億円 (八王子第6工場など)
- 同 減価償却は12億円
- 16年度通期計画に変更なし

◆ 半導体製造装置

- 足許の市況は好調
- メモリ・車載向けに加え、電子部品向けも堅調
- 更に、中国の需要に期待

◆ 計測機器

- 内需・自動車向けは引き続き堅調
- 外需(特にアジア)は低迷も、一部に回復の兆し
- 工作機械受注動向は引き続き注視

- 半導体製造装置事業：足許市況は好調
メモリ・車載向けに加え、電子部品向けも堅調
更に、各社の中国での設備投資需要に大きな期待
- 計測事業：内需・自動車関連、航空機業界の需要は引き続き堅調
アジア中心に外需は低迷するも、足許では一部地域で回復の兆しが出始めている
また、工作機械受注が 昨年夏場以降 若干減速傾向、引き続き動向を注視する

2016年度 通期業績予想

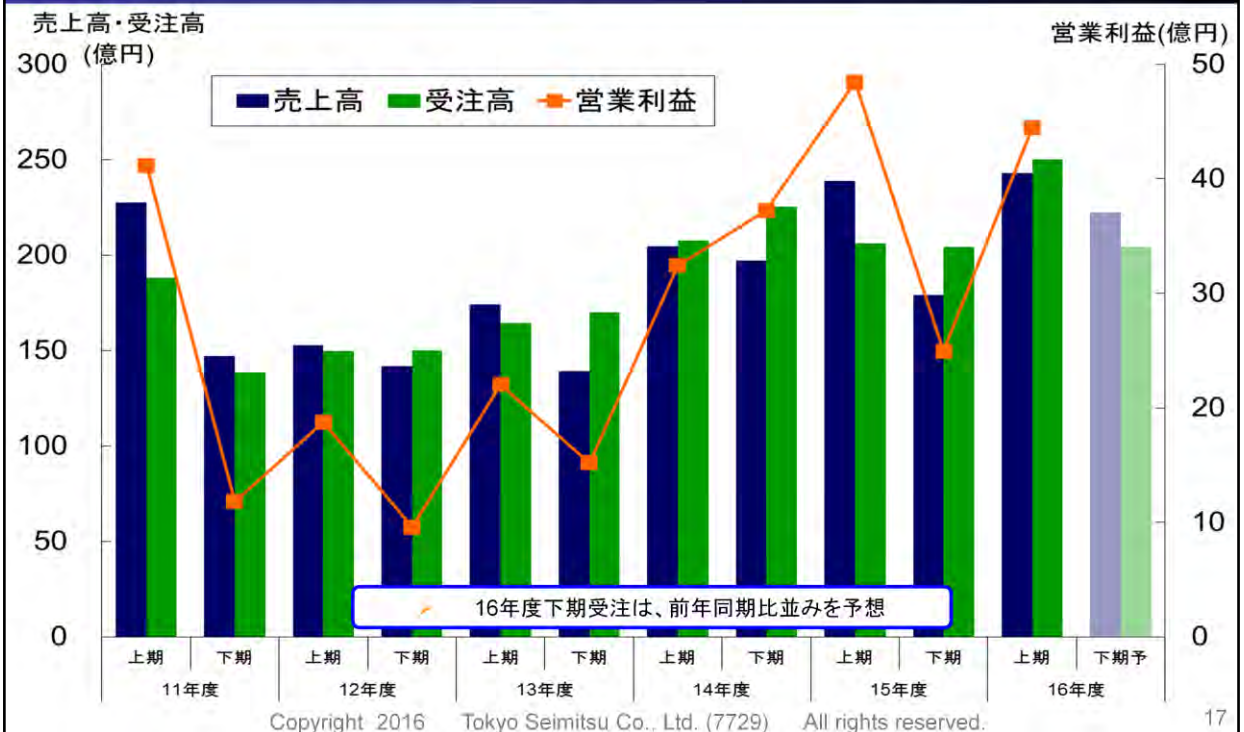
単位: 億円(配当除く)	15年度			16年度				
	上期	下期	通期	上期	下期 予想	通期 予想	前回 予想 対比	前年比
売上高	380	323	703	372	353	725	+35	+3%
半導体	239	179	418	243	222	465	+57	+11%
計測	141	144	285	129	131	260	-22	-9%
営業利益	76	56	132	66	64	130	+15	-2%
同率	20%	17%	19%	18%	18%	18%	-	-
経常利益	77	56	132	63	65	128	+13	-3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	55	42	98	47	47	94	+10	-3%
1株配当	26円	33円	59円	34円	34円	68円	+8円	+9円

前回予想公表: 2016年8月9日

- 16年度業績予想を修正
- 売上高 725億円、営業利益130億円、経常利益 128億円、当期純利益94億円を予想
- 配当方針 (配当性向30%目安)を踏まえ、通期1株配当予想を60円→68円へ修正

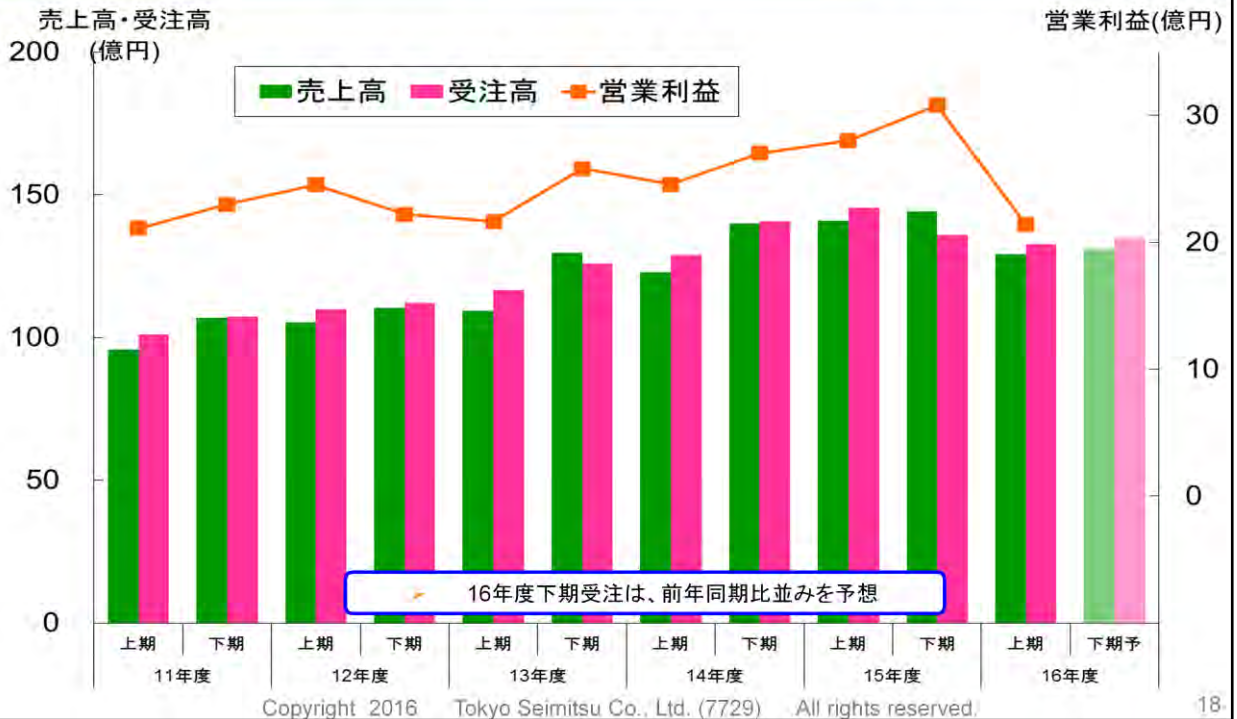
(詳細は、2016年11月11日公表の「業績予想並びに剰余金の配当及び
期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください)

半導体事業 - 売上・受注高 見込



- 16年下期の半導体事業の受注高は、上期比では減少するものの、前年下期並みを予想
- 16年度通期受注高は、前年度を上回る見通し

計測事業 - 売上・受注高 見込



- 16年下期の計測事業の受注高は、一部の外需に回復の兆しが見えることから上期比で増加し、前年下期並みの着地を予想

**世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の商品
を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく**

理念を示すモットー:

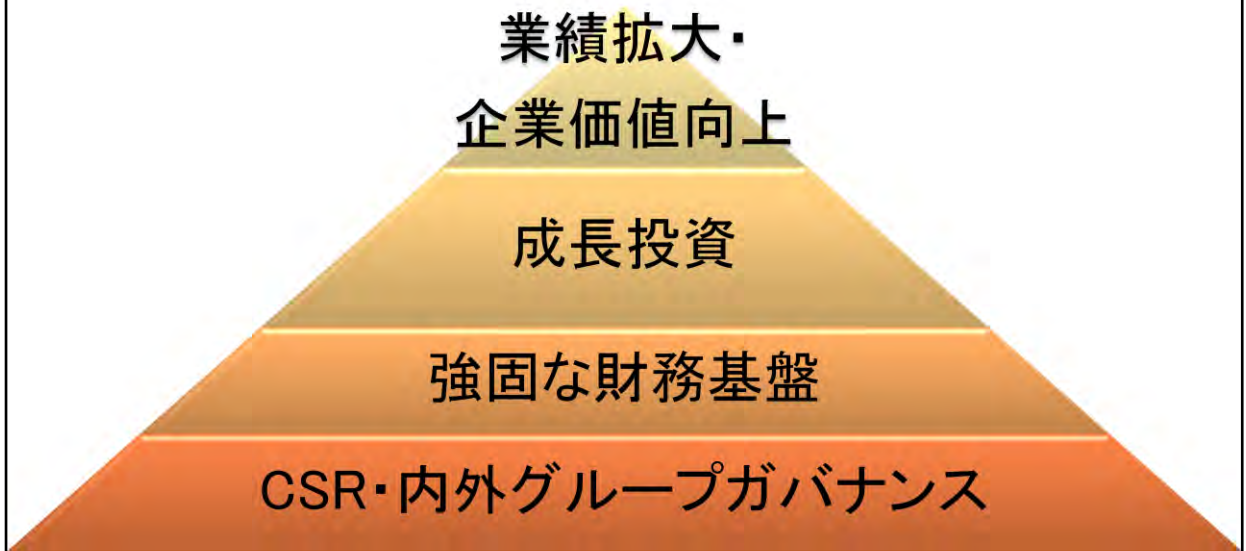
「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」
WIN-WIN relationships create the World's No. 1 Products

コーポレートブランド:

ACCRETECH

“Accrete (共生)” と “Technology (技術)” の合成語

- 長期指標のベースにある、当社の企業理念は:
「世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して
世界No.1の商品を創り出し、皆様と共に大きく成長してゆく」
- これを簡潔に表すモットー、及びコーポレートブランド
「ACCRETECH(アクレーテク)」を掲げ、理念の実現に取り組んでいる



- ベースとして CSR、内外グループガバナンスに基づく強固な財務基盤が必要
- これらを基に成長投資を続け、継続的な業績拡大と企業価値向上を図る

半導体 事業

- ・ 強み: 精密位置決め制御技術、内製化
- ・ チャンス: 新技術・新デバイス

計測 事業

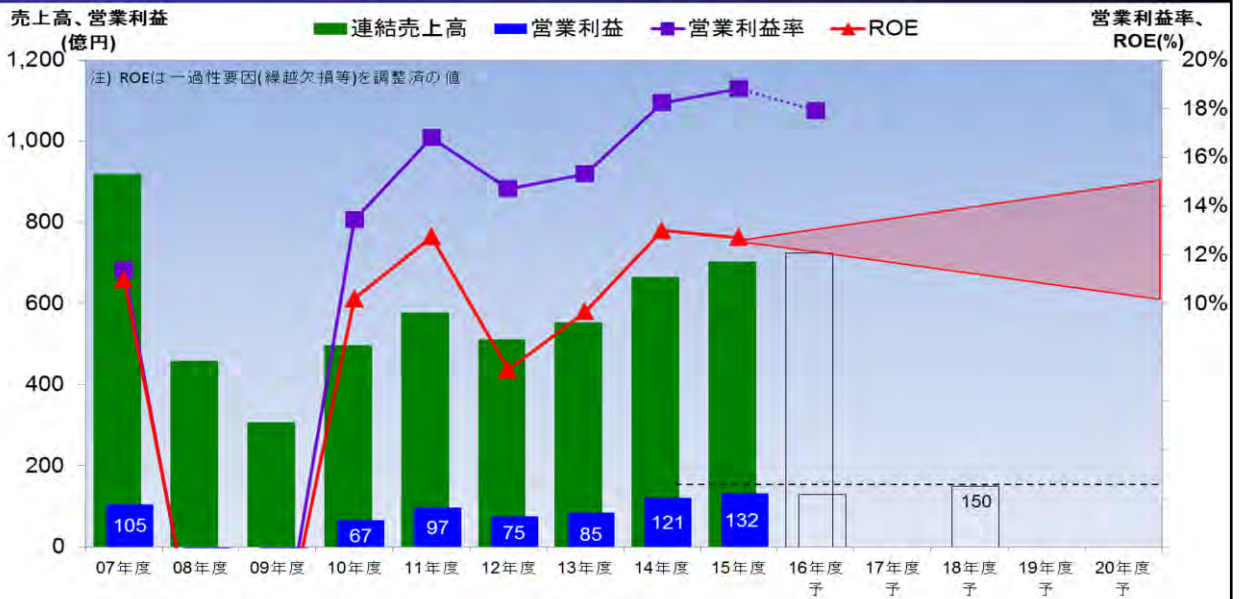
- ・ 強み: 高精度・高分解能測定技術、信頼性
- ・ チャンス: 新分野・新興国を含む海外需要

- ・ **バランスの取れた事業構成**
- 異なる事業領域を有することによる安定性(需要変動影響を吸収)

- 当社の半導体事業は、精密位置決め制御技術と、内製化が強み
半導体新技術・新デバイスなどが業容拡大のチャンス
- 計測は、高精度及び高分解能を実現する測定技術と、その信頼性が強み
信頼性を必要とする新分野や、海外需要などが業容拡大のチャンス
- 需要の波が異なるセグメントを有する事業構成が、全社業績の安定化に寄与



長期的な指標、中期目標



- ◆ 長期指標: ROE 10%以上の企業体質の維持
- ◆ 中期目標(~18年度): 営業利益 既往ピーク 150億円の更新

Copyright 2016 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729) All rights reserved.

22

- 長期指標「ROE10%以上の企業体質を維持する」
中期目標(~2018年度)「営業利益 既往ピーク150億円の更新」

メインストリーム(主力マーケット)で競争力を高めつつ
安定需要・成長期待分野へ資源投下

半導体

主力市場:

- ・モバイル
- ・ストレージ
- ・自動車



安定需要・成長市場:

- ・中国市場
- ・IoT(特に小ウエハ)
- ・消耗品



計測

主力市場:

- ・自動車及び自動車部品
- ・工作機械



安定需要・成長市場:

- ・航空機
- ・オートメーション
- ・海外市場

継続的な売上と利益の拡大

- 半導体・計測両事業に共通する戦略の骨格は、
主力市場で製品競争力を維持しつつ、
安定需要、または安定成長が期待される分野へ資源を投下すること
- 期待される分野
半導体: 中国市場、IoT(モノのインターネット)、消耗品
計 測: 航空機産業、オートメーション化対応、海外市場

最終製品



モバイル



ストレージ



車載デバイス



プローバ:

- 「デパート化」であらゆるニーズ対応
 - －耐環境製品の開発・展開
 - －フレームハンドリング など



ダイサ・ブレード:

- 「ソリューション力」強化
 - －電子部品向け対応力強化
 - －他装置との包括プロセス提案 など



PG/研削装置:

- 最先端プロセス対応
 - －高精度、新材料(SiC、GaN等)対応強化
 - －他装置との包括プロセス提案 など

継続的な売上と利益の拡大

- 安定・成長が見込まれる代表的な最終製品はモバイル、ストレージ、自動車
- プローバは、「デパート化」戦略であらゆる幅広いニーズに対応
- ダイサ、ブレードでは、ソリューション力の強化を軸に開発、対応
- PG、研削装置は、最先端プロセスへの対応がキー



新製品による 売上の拡大

安定・成長業界への製品投入
光学関連測定機の拡販

海外における 売上の拡大

欧米導入事例の横展開

継続的な売上と利益の拡大

- 計測事業の戦略は大きく分けて2つ
- 安定・成長する業界への製品投入と、光学測定機器による売上拡大
- 欧米地域での大手導入事例の横展開による海外売上の拡大



ACCRETECH



東京精密は
アクレーテクです